

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2025-054

转债代码：113616

转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海豪威集成电路集团有限公司（以下简称“上海豪威”），上海豪威为公司全资子公司，本次担保不构成关联担保。

● 本次担保金额及实际已为其提供的担保余额：本次因上海豪威向银行申请授信贷款事项提供担保，公司担保金额为 98,000 万元。截至本公告日，包含本次担保在内公司累计为其提供担保余额为 105,900 万元。本次担保事项后的累计担保余额均在公司股东大会批准的担保额度范围内。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

1、公司与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）签订了《不可撤销担保书》，为确保公司子公司上海豪威与招商银行申请银行授信额度签订的《固定资产借款合同》的履行，公司作为保证人同意为上海豪威在借款合同项下的全部债务承担连带保证责任，本次担保金额为人民币 28,000 万元，本次担保未提供反担保。

2、公司与中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行（以

下简称“民生银行”)签订了《保证合同》,为确保公司子公司上海豪威与民生银行申请银行授信额度签订的《固定资产借款合同》的履行,公司作为保证人同意为上海豪威在借款主合同项下的全部/部分债务提供保证担保,本次担保金额为人民币 70,000 万元,本次担保未提供反担保。

截至本公告披露日,包含本次担保在内公司累计为上海豪威提供担保余额为 105,900 万元。本次担保事项后的累计担保余额均在公司股东大会批准的担保额度范围内。

(二) 本担保事项履行的内部决策程序

2024 年 6 月 25 日,公司召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度的议案》,确定公司为控股及全资子公司的银行及其它金融机构信贷业务以及日常经营业务提供担保,担保额度合计不超过等值人民币 40 亿元人民币及外币融资,其中为上海豪威担保额度合计不超过等值人民币 15 亿元人民币及外币融资。公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内,公司为控股及全资子公司在上述担保总额度内签订的担保合同均为有效。详情请见公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-048)。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况

- 1、被担保人名称:上海豪威集成电路集团有限公司
- 2、统一社会信用代码:91310000MA1H3X5962
- 3、成立时间:2021 年 7 月 2 日
- 4、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
- 5、法定代表人:王崧
- 6、注册资本:50,000.00 万元人民币

7、主营业务：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；从事集成电路领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、主要股东或实际控制人：公司持有上海豪威 100%的股权

9、最近一年又一期财务指标：

单位：人民币/万元

财务指标	2024.12.31（经审计）	2025.3.31（未经审计）
资产总额	103,538.50	147,540.00
负债总额	74,109.72	119,869.06
净资产	29,428.78	27,670.94
	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	200,669.36	94,549.63
净利润	-1,894.64	-1,757.85

（二）上述被担保人为公司全资子公司，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

（一）招商银行《不可撤销担保书》

1、合同签署人

保证人：上海韦尔半导体股份有限公司

债权人：招商银行股份有限公司上海分行

债务人：上海豪威集成电路集团有限公司

2、担保金额：人民币 28,000 万元

3、保证方式：连带保证责任

4、保证范围：本保证人保证担保的范围为主合同项下债务人的全部债务，

具体包括：

（1）债权人根据主合同向债务人发放的贷款、议付款本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；

（2）债权人因履行主合同项下所承兑的商业汇票或所开立的信用证项下付款义务而为债务人垫付的垫款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；

（3）债权人在主合同项下所贴现的全部汇票金额本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；

（4）债权人实现担保权和债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等）及其他一切相关费用；

（5）如主合同项下贷款系应债务人申请对旧贷、票据贴现款或信用证议付款进行偿还或转化，或债权人应债务人申请，在保证责任期间内以新贷偿还主合同项下信用证、票据等垫款债务的，本保证人确认由此产生的债务纳入担保范围。

5、保证责任期间：自本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。借款或其他债务展期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

（二）民生银行《保证合同》

1、合同签署人

保证人：上海韦尔半导体股份有限公司

债权人：中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行

债务人：上海豪威集成电路集团有限公司

2、担保金额：人民币 70,000 万元

3、保证方式：连带责任保证

4、保证范围：本合同约定的被担保的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、

复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有款项和其他应付合理费用等，统称“实现债权和担保权利的费用”）。上述范围中的所有款项统称为“主债权本息及其他应付款项”。

对于保证人为履行本合同项下责任而向债权人支付的任何款项（包括被债权人直接扣收/扣划的任何款项），按下列顺序清偿：（1）债权人实现债权和担保权利之费用；（2）损害赔偿金；（3）违约金；（4）复利；（5）罚息；（6）利息；（7）本金/垫款/付款。当债权人已发放的贷款逾期超过九十日时，债权人有权将前述清偿债权的顺序调整为：（1）实现债权和担保权利的费用；（2）本金/垫款/付款；（3）利息；（4）复利；（5）罚息；（6）违约金；（7）损害赔偿金。保证人知悉：发生前述情形时，债权人有权视具体情况选择是否调整清偿顺序，但并不构成债权人必须履行的义务。

5、保证期间：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。主债务人分期清偿债务的情形下，“主债务人履行债务期限届满之日”为最后一期债务履行期限届满之日，以及根据主合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。

四、担保的必要性和合理性

（一）本次担保是基于上海豪威的经营发展需要确定的，有利于满足其当前业务需求，确保业务正常开展。本次担保不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，符合公司整体利益。本次担保额度在 2023 年年度股东大会审议的担保预计范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）上海豪威为公司全资子公司，根据公司目前项目的经营情况和未来发展计划，上海豪威经营状况稳定，有能力偿还借款，并解除相应担保，担保风险在可控范围内，不存在影响其偿债能力的重大事项。

五、董事会意见

公司第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度的议案》，董事会同意为确保控股子公司正常的生产经营需要，提高控股子公司的融资能力，为控股子公司的银行及其它金融机构信贷业务以及日常经营业务提供担保。同时，本次预计担保的被担保方均为公司控股子公司，公司控股子公司经营状况稳定，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，包括本担保在内，公司实际对外担保金额为人民币 105,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.38%，均为公司与控股子公司之间的担保；公司无逾期担保的情况。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日